

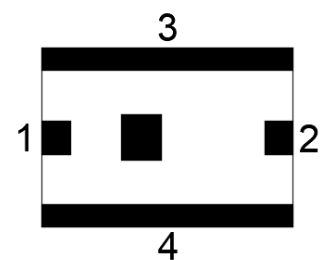
特性

- 多层单片结构，可靠性高
- 低插损，小尺寸 **z** 贴设计
- 简化复杂的调螺和电路设计
- 低温共烧陶瓷工艺

电性能

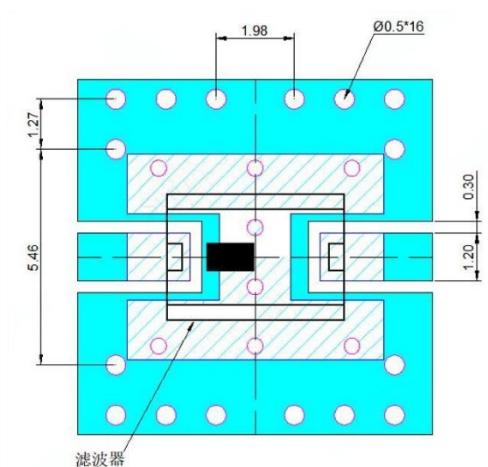
NO.	Parameter	Frequency (MHz)	SPEC		
			Min.	Typ.	Max.
1	插损 (dB)	1800-3000	/	/	4.0
2	插损波动 (dB)	1800-3000	/	/	2.0
3	抑制 (dB)	1-1200	30	/	/
		3400-6000	30	/	/
4	驻波	1800-3000	/	/	2.0
5	输入/输出阻抗(Ω)		50		
工作和储存条件					
工作温度范围: -40℃ ~ +85℃					
储存温度范围: -40℃~ +85℃					
焊接前的储存条件 (包含包装材料)					
储存温度范围: +5 ~ +40 ℃					
湿度: 相对湿度 30 to 70%					

结构



PIN	Connection
1	Input Port
2	Output Port
3	GND
4	GND

焊测版图 (单位: mm)



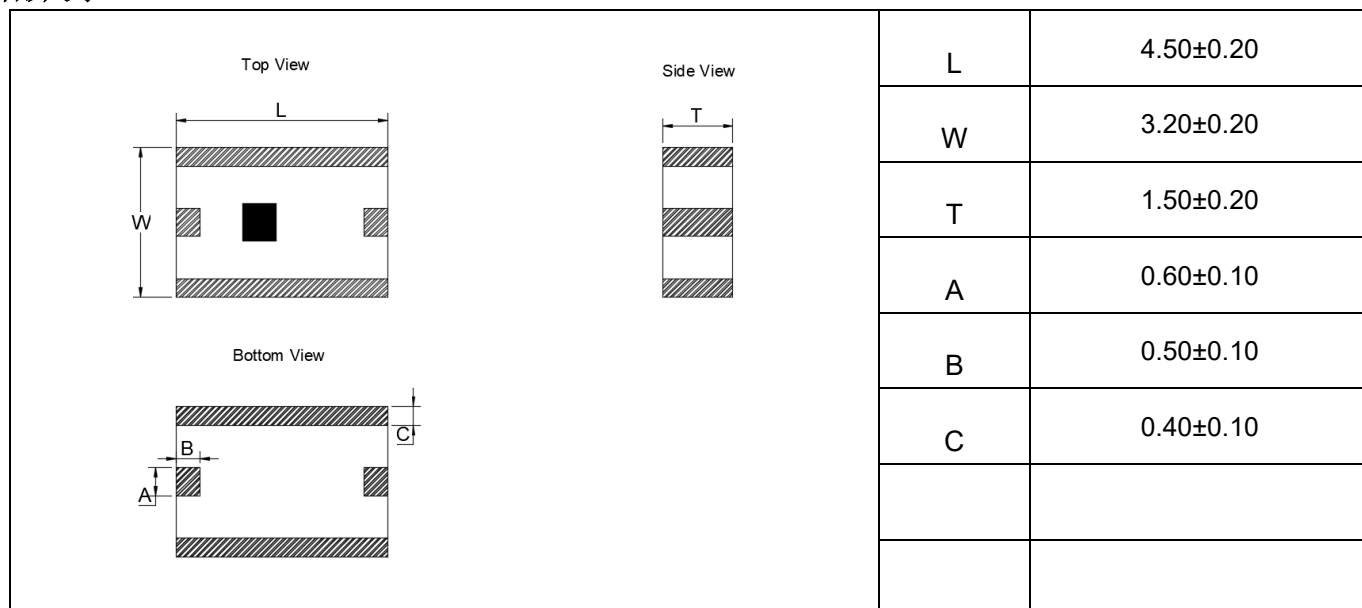
- : PCB夹具板
- ▨ : 代表PCB焊盘

说明:

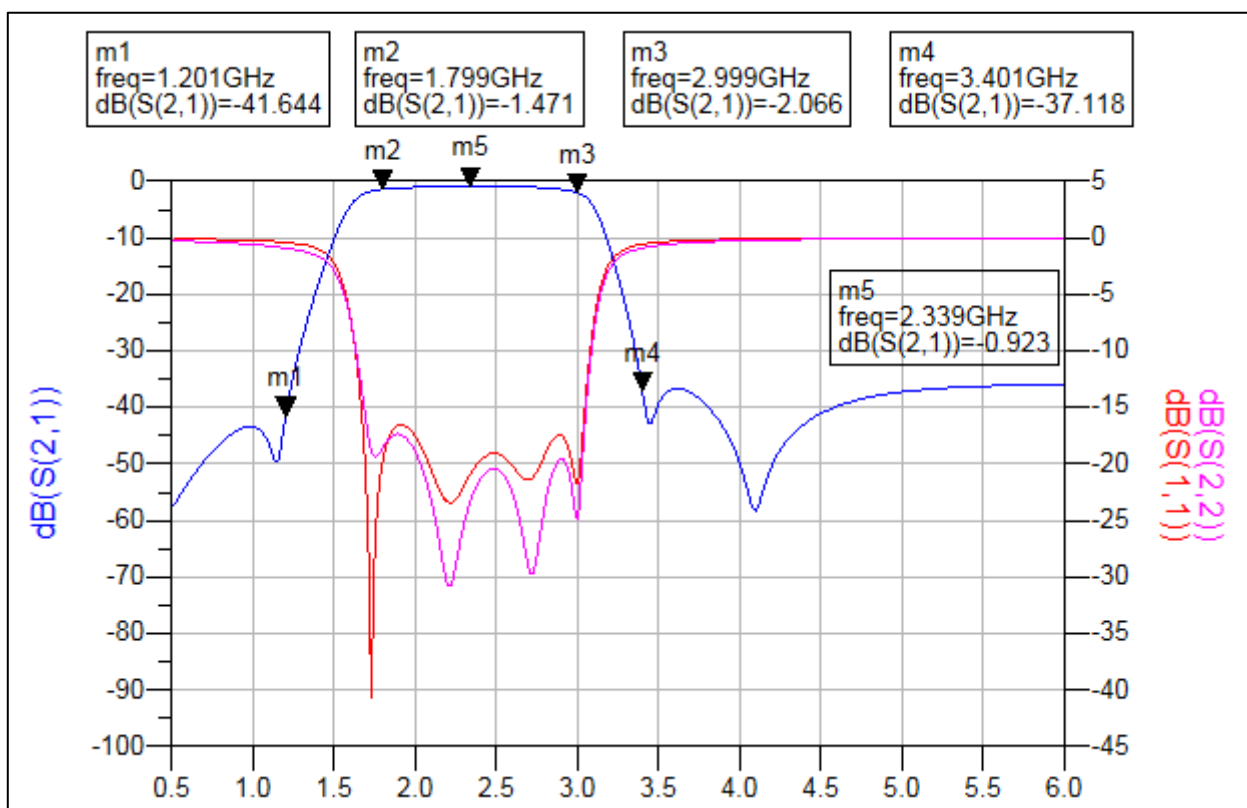
- 1、板材 FR4, 介电常数 4.4;
- 2、铜厚 0.035mm;
- 3、板厚 1mm;
- 4、夹具尺寸 30mm*30mm;

线宽需要根据 PCB 的材料和厚度进行设计, 以匹配 50 欧姆的特性阻抗

外形尺寸



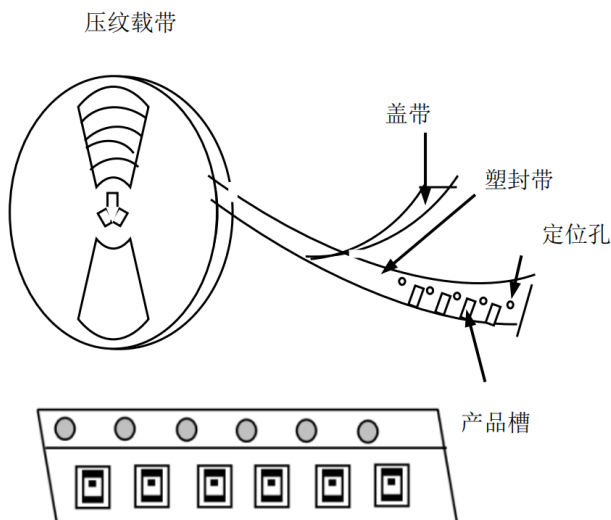
电性能 (T=25°C)



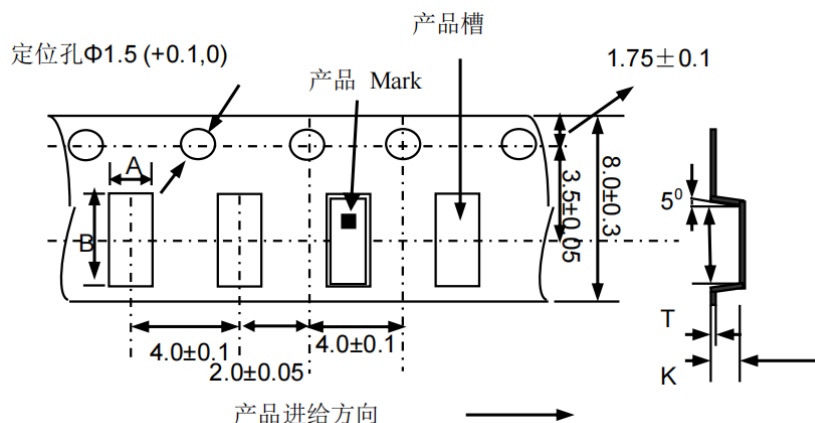
包装和储存

1. 包装

1.1 编带图 (单位: mm)



1.2 编带尺寸 (单位: mm)



类型	产品厚度	A	B	K max	T max	数量 (pcs/单盘)
	1.50±0.20	3.50±0.15	4.8±0.15	1.80	0.33	1000

2 使用、储存及搬运要求

2.1 使用环境

滤波器使用温度范围为-55℃~+125℃。

2.2 储存环境

滤波器应储存在环境温度为-5℃~30℃、相对湿度为20%~75%，无酸、碱等有害气体的库房中，储存期限不应超过24个月。

真空包装条件下存储期限不超过36个月。

滤波器以生产日期开始计算起，需在1年内进行使用。超过此期限应对可焊性进行检查。

2.3 搬运要求

不要使产品经受跌落、过强的振动、碰撞或机械冲击。

推荐焊接技术

1 手工焊接

采用电烙铁进行焊接时，不能用电烙铁头划伤端电极，应采用下列工艺进行焊接：

- 1) 焊接用烙铁输出功率：最大60 W；
- 2) 预热烙铁150 °C，1 min；
- 3) 烙铁头焊接温度：不超过 350 °C；
- 4) 烙铁头直径：最大 3.0 mm；
- 5) 焊接时间: 3 s 以内；
- 6) 焊接次数：1 次；
- 7) 推荐电烙铁焊接温度曲线如图 1 所示。

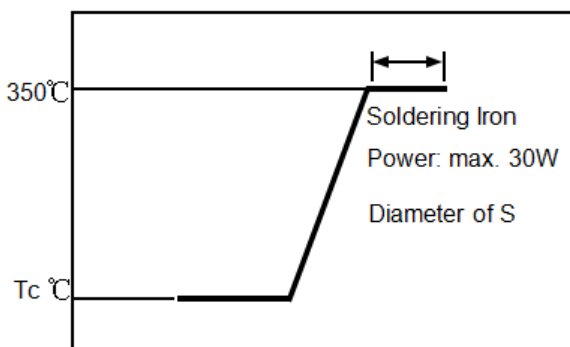


图 1 电烙铁焊接温度曲线

2 回流焊接

采用回流焊机进行焊接时，滤波器最大可承受的回流焊次数为 3 次，如无工艺上的要求，一般不推荐对产品进行多次回流焊。回流焊焊接工艺如下：

- 1) 预热温度：100 °C~150 °C，预热时间：60 s~120 s；
- 2) 焊接温度：183 °C~245°C，持续时间：60 s~90 s；
- 3) 推荐回流焊焊接温度曲线如图 2 所示。

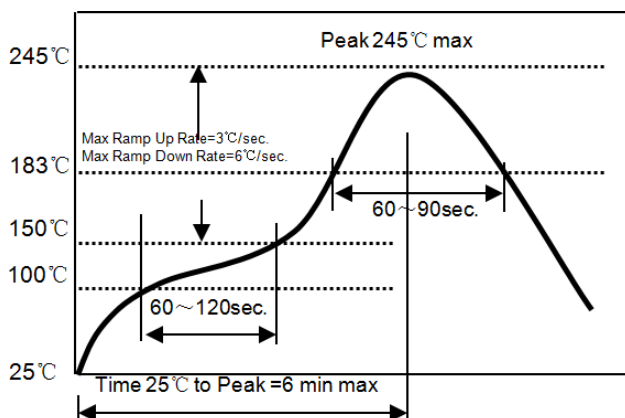


图 2 回流焊焊接温度曲线